

# Fixation Tape for Mobile Device Components

Ideal for Precision Component Fixation & Protection  
| High-Performance Tape Solution

Secures and protects precision parts like cameras, batteries, and sensors inside smartphones. The ultra-thin design prevents shifts, floating, falls, and vibration, ensuring component reliability.



## MATERIAL SPECIFICATIONS

| Item                | Specifications              | Features & Merits                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Thickness     | 0.05 mm (2 mil)             | Ultra-design prevents interference with FPCs and narrow-pitch components                                     |
| Adhesive            | High-heat resistant acrylic | Withstands peak temp of 260°C, low outgassing spec – Can withstand 260°C                                     |
| Substrate           | Non-woven Fabric            | Excellent dimensional stability during die-cutting – High dimensional stability during die-cutting           |
| Liner               | Paper (0.09 mm)             | Maintains releasability after reflow process (Before: 11g/in → After: 15g/in) Releasability is maintained in |
| Standard dimensions | Width 500 mm × Length 100 m | Ideal for simultaneous batch processing on production lines                                                  |

## BASIC PROCESSING SPEC (PROCESSING SPEC)

| Process              | Compatibility · Conditions                        | Remarks                                                                                |                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die-cutting          | High-precision die-cut compatibility              | Non-woven substrate allows for micro-shaped die-cutting                                | Non-woven substrate permits micro-shaped die-cutting                                           |
| Bonding process      | Lamination Process<br>Recommended temp: 21 – 38°C | Recommended Temperatures                                                               | Recommended Temperature: 21–38°C                                                               |
| Heat resistance      | Lead-free solder reflow compatible                | Develops high initial adhesion through proper pressure application                     | Achieves high initial adhesion with appropriate pressure                                       |
| Releasing process    | Re-releasable after reflow                        | Maintains holding power even in 260°C (peak) high-temp environment                     | Maintains holding power even in 260°C peak temp conditions                                     |
| Storage · management | 16 ~ 27°C / 40 ~ 60%RH                            | Can be re-releasable after reflow<br>Ideal for temporary fixation during manufacturing | Can be peeled again after reflow<br>Suitable for temporary fixation in manufacturing processes |

Use within 12 months after manufacture if unopened | Within 12 months from manufacture, when unopened

## Product Strengths (Appeal Points)



### Thin & strong

Though 0.05mm ultra-thin, it withstands 260°C high heat. High reliability.



### Easy to process

Non-woven substrate ensures precise die-cutting and minimal post-processing distortion.



### Doesn't stop process

Maintains high releasability after reflow, reducing the risk of threshold failures on final products.



### Environmentally consideration

Uses RoHS-compliant materials to reduce environmental burden.

## Recommended Uses



### Temporary FPC Fixation

Suitable for temporary fixation of FPCs and flexible substrates on electronics component production lines.



### High-Temperature Soldering Process

Can be used for temporary fixation or masking during high-temp soldering.



### Precision Device Assembly

Perfect for component adhesion in reinforcement during precision equipment assembly.

### USD Price

0.3USD ~ 7USD

(Price varies based on shape, specification, and quantity.)



High-Performance  
Tape Solution



Ideal for Precision Component  
Fixation & Protection



Reliable Quality for  
Safer Devices

### Contact Us

Company : RISORA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED  
Contact : Rumi Imran  
Mobile : +91 89259 44244  
Email : rumi.imran@morimura.in

Rumi Imran  
WhatsApp business account



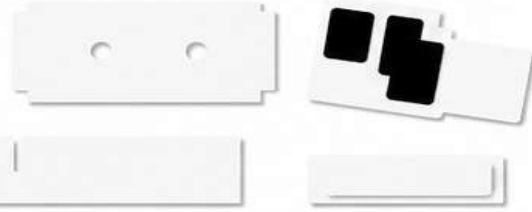
Company : RISORA



# モバイルデバイス用部品固定テープ

精密部品の固定・保護に最適な  
高性能テープソリューション

スマートフォン内部のカメラ、バッテリー、センサーなどの精密部品を  
しっかり固定・保護します。薄型設計により、ズレ・浮き・落下・振動を防ぎ、  
重要部品を確実に守ります。



## 基本材料スペック (Material Spec)

| 項目   | 仕様                  | 特長・メリット                                          |
|------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 総厚み  | 0.05 mm (2 mil)     | 極薄設計で、FPCや狭ピッチ部品への干渉を防止。                         |
| 接着剤  | 高樹脂アクリル             | 260℃のピーク温度に耐える、低アウトガス仕様。                         |
| 基材   | 不織布                 | 打抜き加工時の寸法安定性に優れる。                                |
| ライナー | 紙 (0.09 mm)         | リフロー工程後も剥離性を維持 (Before: 11g/in → After: 15g/in)。 |
| 標準寸法 | 幅 500 mm × 長さ 100 m | 量産ラインでの一括加工に最適。                                  |

## 基本加工スペック (Processing Spec)

| 工程    | 対応能力・条件           | 備考                         |
|-------|-------------------|----------------------------|
| 打抜き加工 | 高精度ダイカット対応        | 不織布基材により、微細形状の抜き加工が可能。     |
| 貼合工程  | 推奨温度：21～38℃       | 適切な圧着により、高い初期接着力を実現。       |
| 耐熱工程  | 鉛フリーはんだリフロー対応     | 260℃ (ピーク) の高温環境下でも保持力を維持。 |
| 剥離工程  | リフロー後も再剥離可能       | 製造工程における一時固定用途に最適。         |
| 保管・管理 | 16～27℃ / 40～60%RH | 未開封で製造から12ヶ月以内に使用。         |

## 製品の強み (アピールポイント)



### 薄くて強い

0.05mmの極薄でありながら、  
260℃の高熱に耐える  
高い信頼性。



### 加工しやすい

不織布基材により、  
精密な打抜き (ダイカット)  
加工後の反りや歪みが少ない。



### 工程を止めない

リフロー後の剥離性に優れ、  
最終製品への関値リスクを  
低減。



### 環境にも配慮

RoHS対応素材を使用し、  
環境負荷を低減します。

## 推奨用途



### FPCの一時固定

電子部品製造ラインにおける  
FPCやフレキシブル基板等の  
一時固定に最適。



### 高温はんだ工程

高温はんだ工程時の部品  
仮固定や、マスキングに  
使用可能。



### 精密機器の組立

精密機器の組立における  
部品密着補強プロセスに  
最適。

## USD価格

**0.3USD～7USD**

(※価格は形状・仕様・数量により変動します。)

☑ 高性能

☑ 信頼性

☑ 環境配慮

精密機器の品質と生産性を支える、最適なテープソリューションを提供します。

## Contact Us

Company : RISORA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED  
Contact : Rumi Imran  
Mobile : +91 89259 44244  
Email : rumi.imran@morimura.in

Rumi Imran  
WhatsApp business account



Company : RISORA

